



平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年7月28日

上場取引所 東

上場会社名 東京エレクトロン株式会社
 コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 常務執行役員
 四半期報告書提出予定日 平成27年8月7日
 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(氏名) 東 哲郎
 (氏名) 堀 哲朗

TEL 03-5561-7000

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第1四半期	155,762	2.9	30,279	77.4	30,207	78.6	19,481	64.6
27年3月期第1四半期	151,325	46.3	17,069	—	16,913	—	11,835	—

(注) 包括利益 28年3月期第1四半期 21,616百万円 (76.6%) 27年3月期第1四半期 12,241百万円 (485.0%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
28年3月期第1四半期	109.53	109.22
27年3月期第1四半期	66.04	65.88

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
28年3月期第1四半期	841,934	627,384	74.2
27年3月期	876,153	641,162	73.0

(参考) 自己資本 28年3月期第1四半期 624,887百万円 27年3月期 639,483百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
27年3月期	10.00	30.00	35.00	68.00	143.00
28年3月期	—	—	—	—	—
28年3月期(予想)	—	105.00	—	83.00	188.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	338,500	15.0	53,500	77.7	53,500	68.4	37,000	84.8	209.04
通期	645,000	5.2	95,000	7.8	95,000	2.2	66,000	△8.2	373.78

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無
詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	28年3月期1Q	180,610,911 株	27年3月期	180,610,911 株
② 期末自己株式数	28年3月期1Q	4,469,768 株	27年3月期	1,344,892 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年3月期1Q	177,865,767 株	27年3月期1Q	179,203,670 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、平成27年7月28日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	5
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	6
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	6
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	6
3. 四半期連結財務諸表	7
(1) 四半期連結貸借対照表	7
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報等)	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間につきましては、世界経済の一部に弱さがみられるものの、足元は堅調に推移しております。日本においても、政府の経済・金融政策を背景に、景気は緩やかな回復基調を維持しております。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、パソコン需要の低迷等がみられましたが、高性能スマートフォン市場向けの需要は根強く、また、デジタルデータ通信量の増加基調に対応するためのサーバー等の需要も底堅く推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループの当第1四半期連結累計期間の連結業績は、売上高1,557億6千2百万円(前年同期比2.9%増)、営業利益302億7千9百万円(前年同期比77.4%増)、経常利益302億7百万円(前年同期比78.6%増)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は194億8千1百万円(前年同期比64.6%増)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

なお、当第1四半期連結会計期間から、事業撤退を発表しております「P V(太陽光パネル)製造装置」事業につきましては重要性が低下したため、報告セグメントから除外し、「その他」の区分に含めて記載する方法に変更しております。以下の前年同期比較については、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

① 半導体製造装置

高性能スマートフォンやデータセンター向けサーバーなどに用いられるDRAMおよびNANDフラッシュメモリー等の需要を背景としたメモリーメーカーの設備投資は堅調に推移し、ロジック系半導体メーカーの先端技術への設備投資も継続しております。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、1,403億6千5百万円(前年同期比3.1%増)となりました。

② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

FPD製造装置市場は中国における大型液晶パネル向けの設備投資が続いているものの、中小型液晶パネル向け投資については一服感がみられました。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、100億7千万円(前年同期比27.7%減)となりました。

③ その他

当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、53億2千6百万円(前年同期比319.6%増)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	前期通期				当期第1Q	
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
売上高	613,124	151,325	142,948	137,021	181,829	155,762
半導体製造装置	576,242	136,126	136,500	131,993	171,622	140,365
日本	87,747	13,421	26,084	19,081	29,160	25,011
米国	135,341	33,790	33,906	32,041	35,603	30,776
欧州	58,768	12,530	12,189	19,054	14,992	17,053
韓国	97,364	22,451	14,695	18,103	42,114	28,140
台湾	139,423	38,456	38,352	28,598	34,017	23,130
中国	39,713	13,911	7,069	6,322	12,409	14,084
東南アジア他	17,883	1,565	4,202	8,791	3,324	2,169
F P D製造装置	32,709	13,929	5,099	3,751	9,928	10,070
その他	4,172	1,269	1,348	1,276	278	5,326
営業利益	88,113	17,069	13,045	22,081	35,916	30,279
経常利益	92,949	16,913	14,860	25,005	36,169	30,207
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	71,888	11,835	8,181	17,451	34,420	19,481

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

【生産及び受注の実績】

1. 生産実績

(単位：百万円)

	前期通期				当期第1Q	
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
半導体製造装置	559,926	124,318	123,037	145,775	166,795	147,830
F P D製造装置	33,230	7,419	3,033	10,953	11,824	10,435
その他	3,488	1,081	1,191	1,110	105	5,124
合 計	596,645	132,818	127,262	157,839	178,724	163,390

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 受注実績 (受注高)

(単位：百万円)

	前期通期				当期第1Q	
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
半導体製造装置	626,795	137,297	142,474	167,264	179,759	156,663
F P D製造装置	35,301	14,280	4,849	3,474	12,696	11,847
その他	△1,129	708	133	1,559	△3,530	1,835
合 計	660,967	152,286	147,457	172,298	188,924	170,346

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位：百万円)

	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	当期第1Q
半導体製造装置	211,085	217,059	252,330	260,467	276,766
F P D製造装置	29,371	29,121	28,844	31,611	33,388
その他	8,433	7,219	7,501	3,692	201
合計	248,889	253,399	288,675	295,771	310,355

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 財政状態に関する説明

① 財政状態

当第1四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ306億4千6百万円減少し、6,402億3千6百万円となりました。主な内容は未収消費税等の減少195億5千8百万円、受取手形及び売掛金の減少128億8千3百万円、現金及び預金の減少99億3千8百万円、有価証券に含まれる短期投資の減少88億7百万円、たな卸資産の増加192億2千2百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から15億5千9百万円減少し、1,053億3千6百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から3億8千6百万円減少し、271億8千万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から16億2千7百万円減少し、691億8千万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から342億1千9百万円減少し、8,419億3千4百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ172億8千5百万円減少し、1,555億2千7百万円となりました。主として、前受金の減少85億4千5百万円、賞与引当金の減少69億4千1百万円、支払手形及び買掛金の減少54億3千7百万円、未払法人税等の増加29億7千1百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ31億5千6百万円減少し、590億2千2百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ137億7千7百万円減少し、6,273億8千4百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益194億8千1百万円を計上したことによる増加、自己株式の取得241億1千9百万円による減少、前期の期末配当121億9千万円の実施による減少によるものであります。この結果、自己資本比率は74.2%となりました。

② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ487億3千4百万円減少し、2,688億9千7百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資300億3千8百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ187億4千6百万円減少し、2,989億3千6百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ9億4千6百万円増加の173億9千4百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益290億9千9百万円、未収消費税等の減少195億6千4百万円、売上債権の減少134億2千7百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、たな卸資産の増加185億1千5百万円、前受金の減少93億8千7百万円、賞与引当金の減少69億9千2百万円、仕入債務の減少61億2千3百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出になったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として定期預金及び短期投資の増加による支出299億8千7百万円、有形固定資産の取得による支出21億5千2百万円により、前年同期の210億6千万円の収入に対し320億2千8百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に自己株式の取得による支出241億1千9百万円、配当金の支払121億9千万円により、前年同期の46億1千4百万円の支出に対し363億6千2百万円の支出となりました。

【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第1四半期 連結累計期間	当第1四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,447	17,394
税金等調整前四半期純利益	15,022	29,099
減価償却費	4,717	4,624
売上債権の増減額(△は増加)	8,231	13,427
たな卸資産の増減額(△は増加)	4,992	△18,515
仕入債務の増減額(△は減少)	△4,096	△6,123
その他	△12,420	△5,117
投資活動によるキャッシュ・フロー	21,060	△32,028
定期預金及び短期投資の増減額(△は増加)	22,300	△29,987
その他(固定資産の取得等)	△1,239	△2,041
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,614	△36,362
自己株式の純増減額(△は増加)	△38	△24,119
その他	△4,576	△12,242
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,273	2,262
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	34,166	△48,734
現金及び現金同等物の期首残高	104,797	317,632
現金及び現金同等物の四半期末残高	138,963	268,897
現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高	280,011	298,936

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

半導体市場環境及び当社の足元の受注状況に鑑み、第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想を修正いたします。

平成28年3月期の連結業績予想

	第2四半期連結累計期間	通 期
売上高	3,385億円(前年同期比 15.0%増)	6,450億円(前年同期比 5.2%増)
半導体製造装置	3,150億円(前年同期比 15.5%増)	5,940億円(前年同期比 3.1%増)
F P D製造装置	180億円(前年同期比 5.4%減)	450億円(前年同期比 37.6%増)
その他	55億円(前年同期比110.1%増)	60億円(前年同期比 43.8%増)
営業利益	535億円(前年同期比 77.7%増)	950億円(前年同期比 7.8%増)
経常利益	535億円(前年同期比 68.4%増)	950億円(前年同期比 2.2%増)
親会社株主に帰属する 当期(四半期)純利益	370億円(前年同期比 84.8%増)	660億円(前年同期比 8.2%減)

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額ははありません。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	79,382	69,443
受取手形及び売掛金	110,845	97,961
有価証券	238,532	229,492
商品及び製品	112,301	126,313
仕掛品	41,483	44,413
原材料及び貯蔵品	21,803	24,083
その他	66,913	48,620
貸倒引当金	△378	△93
流動資産合計	670,882	640,236
固定資産		
有形固定資産	106,896	105,336
無形固定資産		
のれん	9,067	8,957
その他	18,499	18,222
無形固定資産合計	27,566	27,180
投資その他の資産		
その他	72,692	71,072
貸倒引当金	△1,884	△1,892
投資その他の資産合計	70,807	69,180
固定資産合計	205,271	201,698
資産合計	876,153	841,934
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	56,478	51,041
未払法人税等	6,196	9,168
製品保証引当金	10,441	10,305
その他の引当金	13,151	5,368
その他	86,543	79,643
流動負債合計	172,812	155,527
固定負債		
その他の引当金	374	374
退職給付に係る負債	51,104	51,041
その他	10,699	7,605
固定負債合計	62,178	59,022
負債合計	234,991	214,549
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,023	78,023
利益剰余金	488,816	496,043
自己株式	△9,064	△33,008
株主資本合計	612,736	596,019
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	9,463	10,016
繰延ヘッジ損益	122	94
為替換算調整勘定	12,481	14,609
退職給付に係る調整累計額	4,681	4,147
その他の包括利益累計額合計	26,747	28,868
新株予約権	1,420	2,276
非支配株主持分	257	220
純資産合計	641,162	627,384
負債純資産合計	876,153	841,934

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
売上高	151,325	155,762
売上原価	95,942	90,057
売上総利益	55,383	65,704
販売費及び一般管理費		
研究開発費	16,754	17,577
その他	21,558	17,848
販売費及び一般管理費合計	38,313	35,425
営業利益	17,069	30,279
営業外収益		
受取配当金	305	268
その他	557	600
営業外収益合計	863	869
営業外費用		
為替差損	852	810
その他	166	130
営業外費用合計	1,019	941
経常利益	16,913	30,207
特別利益		
固定資産売却益	55	258
投資有価証券売却益	54	-
特別利益合計	110	258
特別損失		
関係会社株式売却損	1,609	1,110
その他	392	255
特別損失合計	2,001	1,366
税金等調整前四半期純利益	15,022	29,099
法人税等	3,169	9,610
四半期純利益	11,853	19,488
非支配株主に帰属する四半期純利益	18	7
親会社株主に帰属する四半期純利益	11,835	19,481

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
四半期純利益	11,853	19,488
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	269	555
繰延ヘッジ損益	△117	△32
為替換算調整勘定	739	2,129
退職給付に係る調整額	△498	△521
持分法適用会社に対する持分相当額	△5	△3
その他の包括利益合計	387	2,127
四半期包括利益	12,241	21,616
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	12,221	21,602
非支配株主に係る四半期包括利益	19	14

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、平成27年4月27日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この取得等により自己株式は、当第1四半期連結累計期間において23,944百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末において33,008百万円となりました。

(セグメント情報等)

① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント		その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置				
売上高	140,365	10,070	8,202	158,638	△2,876	155,762
セグメント利益	32,240	1,343	2,184	35,767	△6,668	29,099

- (注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流、施設管理及び保険業務等並びにPV(太陽光パネル)製造装置事業であります。
2. セグメント利益の調整額△6,668百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△3,083百万円等であります。
3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントの変更等に関する事項

当第1四半期連結会計期間より、「PV製造装置」事業について重要性が低下したため、同事業を報告セグメントから除外し、「その他」に含めて記載する方法に変更しております。

④ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。